

半導體與重點科技產業人才發展基地

多元半導體人才養成班第 01 期

招生簡章

主辦單位 | 勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

承辦單位 | 國立陽明交通大學、陽明交大雷射系統研究中心

訓練領域 | 電子電機

訓練職類 | 電機工程

課程時數 | 212 小時

訓練期間 | **112 年 03 月 01 日(三)~112 年 04 月 29 日(六)**

上課時間 | 週一~週五 10:00~17:30 (部分週六上課)

上課地點 | 採遠距教學 或 實體授課

實體地點：新竹市大學路 1001 號 國立陽明交通大學 科學三館(基礎科學大樓)

訓練費用 | 35,952 元。政府負擔費用：28,762 元，學員自行負擔：7,190 元。

符合自願/非自願失業者身分者，曾有投保紀錄，目前退保且待業中，訓練費用全免。

報名期間 | 即日起 至 112 年 02 月 14 日(二) 下午 11:59 止。

甄試日期 | 112 年 2 月 19 日(日) 上午 9:00。

甄試地點 | 新竹市大學路 1001 號 國立陽明交通大學 科學三館(基礎科學大樓)。

錄訓名額 | 40 人。

課程諮詢 | 國立陽明交通大學 蔡小姐 03-5712121#56090、艾小姐 0933-913-733 或
Email 至 soniatsai@m365.nycu.edu.tw。

課程報名 | 請上台灣就業通**登入會員後報名。**

主辦單位：勞動部勞動力發展署桃竹苗分署 廣告

核准文號：111年11月25日 桃分署廣字第1110027628號

■ 課程簡介

近期 COVID-19 病毒肆虐全球，反而更加凸顯台灣半導體產業鏈的重要性，不但具有完整上中下游，其產值更佔全球半導體產業將近 20%。除了 5G 與 AI 等應用帶動更多需求，再有中美貿易國際情勢下，導致轉單效應持續加速，使得台灣從 IC 設計到晶元代工再到封裝測試產業一片榮景。台灣半導體產業 2020 年產值已突破三兆元，產業蓬勃發展，卻出現人才荒。力積電董事長黃崇仁：『全球晶圓代工產能不足會持續到 2022 年之後，原因包括需求成長率大於產能成長率；且包括 5G 及 AI 等應用帶動更多需求。然而建造新晶圓廠成本高昂且至少需時三年以上，期待新產能緩不濟急，產能吃緊已經到了客戶會恐慌的情況。』因此面對如此龐大的產能需求，半導體領域科技人才亦是供不應求。根據 104 人力銀行最新「半導體產業及人才白皮書」，半導體徵才在 2021 年 Q2 創新高，平均每月徵才 2.77 萬人，上中下游都缺相關製程的工程師，缺額高達 1.5 萬名。

國立陽明交通大學在過去幾十年間，在半導體產業方面，皆扮演著領航者的角色。於 1958 年首先設立電子研究所，協助政府發展半導體工業。其間設立半導體中心、奈米元件國家實驗室 (National Nano Device Laboratories)，以及台積電、聯發科、鴻海等多家知名科技大廠之專屬研究中心，發展前瞻次微米半導體製程技術，培養半導體產業所需人才，除了教師參與研究外，也培養了無數創業校友，奠定了台灣半導體產業的基礎。陽明交大為了培育更多的實務型科技人才，透過本計畫培養半導體領域之核心知識與素養，規劃半導體領域之職前課程，提供非領域，但想嘗試跨入半導體產業的人，也能有學科及實務上的學習，搭配與廠商業界合作，建立垂直式整合的人才培育，互補各階層科技產業人才需求，提升國內產業人力供給及競爭力問題。

■ 課程目標

1. 陽明交大目標針對先進半導體製程產業成立區域產業人才及技術培育基地，並設計前瞻的跨領域人才培育計畫 (Science-based practical talents for advanced semiconductor industry.)，培養專業知識包含半導體(Semiconductor)、人工智慧(Artificial intelligence)、光電(Photonics)，簡稱 SAP 科技實務人才培育；
2. 洞察國內外半導體產業之脈動，瞭解時事議題與工程技術對環境、社會及全球之影響，以培養學員成為立足於全球之半導體科技人才；
3. 協助失業者及特定對象，增強就業職能、提昇職場競爭力，並順利就業。

■ 課程特色及優勢

本課程設計強調半導體產業應用為目的，結訓後連結國內知名半導體大廠之媒合、預聘、企業實習等為本課程特色。同時，因應經濟發展之趨勢，在教學發展目標與特色上，除去達到高度整合教學資源與師資外，能夠效率化提升多元化半導體專業人才培訓養成。本課程有助於培養微電子積體電路領域的應用工程師和研究型學者，並專注於先進微電子晶片電路的研究，以解決國內半導體產業的人才短缺的問題。本課程的教育目標在養成未來多元半導體產業人才，透過多樣的專業課程，使學生成為在元件設計、可靠度分析、量子物理、材料科學與奈米製程技術上具備良好專業知識的整合人才，並透過堅強的專題研究群，引導學生投入前瞻固態電子元件領域，訓練嚴謹的研究能力與創新思維。

■ 結訓後規劃與可從事行業

1. 本主辦單位將安排訓練期間表現優異之青年，結訓後連結國內知名半導體大廠之媒合、預聘、企業實習等活動。
2. 可從事行業為：半導體製程工程師、半導體設備工程師、半導體元件開發工程師、半導體廠技術員、品質檢驗員...等各項半導體領域職務。

■ 參訓資格

1. 15 歲 (含以上) (以課程開訓日計算) 待業者。
2. 其他條件
 - (1.) 對半導體有興趣，具工作意願且工作技能不足之失業者，但在職勞工、自營作業者、公司或(行)商號負責人(含有限公司及股份有限公司之董事)不得參訓。
 - (2.) 民眾有下列情事之一者，不得報名：
 - 報名班次之開訓日尚於前次完訓或結訓班次之訓後 180 日內。
 - 曾參加職前訓練課程而被退訓，其退訓日尚於報名班次之開訓日前 1 年內。
 - 重覆參加相同班名之職前訓練課程，且其離、退訓日(不含適應期內離訓)、完訓或結訓日尚於報名班次之開訓日前 3 年內。
 - 報名班次之開訓日前二年內，已有二次以上離訓、退訓、完訓或結訓之職前訓練參訓紀錄(不含適應期內離訓)。

【備註】不得報名之參訓歷史統計範圍，以參加勞動部勞動力發署及其所轄各分署自辦、委外或補助辦理之職前訓練課程或班次為限。

(3.) 非自願離職者，需於報名截止日前至公立就業服務機構安排職訓諮詢，經適訓評估後持該機構開立之「職業訓練推介單」報名。

■ 報名方式

1. 成為台灣就業通會員：申請參加計畫前，應登錄為「台灣就業通」會員(電子郵件將作為後續訊息發布通知重要管道，請務必確實填寫)。

2. 線上報名：

(1.) 點選「職前訓練網」：<https://its.taiwanjobs.gov.tw/> (務必先登入再進行課程查詢)；

(2.) 進行課程查詢：課程關鍵字「多元半導體人才養成班」；

(3.) 點選課程頁面之「我要報名」，確認報名資訊及勾選相關欄位；

***報名當下須為失業者身分，投保狀態為退保。**

(4.) 報名完畢後，請務必向訓練單位以 E-mail 聯繫及通知並繳交個人簡歷表及學歷證明至訓練單位指定信箱 - soniatsai@m365.nycu.edu.tw：簡歷表pdf 檔案，內容須包含學歷、經歷與相關背景描述，以人力銀行所下載之簡歷表格式為佳。

※曾研習過半導體之相關課程或線上學習(報名請註明曾修過之課程名稱)。

※專案報名 - 報名期間為在職者 (在保身分)者，參訓期間為失業者身分：

由於台灣就業通要求報名當下就要為退保狀態，因此，若學員在報名期間尚未退保，可另外於以下表單填寫報名資料，將以專案報名形式進行，報名完成後之流程同線上報名。

專案報名表單：<https://forms.gle/gmqAZmazpJziJ4RSA>

3. 報名成功通知：相關資料確認後，將以 e-mail 方式回覆報名收件通知，務必隨時留意。

4. 甄試通知：本課程將進行實體甄試，甄試說明於下節錄訓方式說明，甄試日前將以 e-mail 方式通知相關資訊，務必隨時留意電子郵件之收件匣或垃圾郵件。

5. 甄試結果將公告於招生網站 (<https://base.stem.lasercenter.nycu.edu.tw/>)，錄取學員請依開訓期間參與課程。

6. 課程洽詢：

E-mail：soniatsai@m365.nycu.edu.tw

窗口電話：蔡小姐 03-5712121 #56090 或 艾小姐 0933-906-833

洽詢時間：每週一至週五上午 9:00-下午 6:00

■ 錄訓(甄試)方式

1. 甄試方式：筆試及口試。
2. 甄試地點：新竹市大學路 1001 號 國立陽明交通大學 科學三館(基礎科學大樓)，筆試與口試於同一天進行。
3. 筆試說明：
 - ◇ 筆試內容：邏輯測驗。
 - ◇ 筆試測驗開始 15 分鐘後不得進入試場應試，視為缺考；缺考或違反筆試考場規定情節重大者，不得參加口試。
4. 口試說明：
 - ◇ 考生請備妥個人簡歷與其他有助於審查之資料，於面試時提交予口試委員審閱。
 - ◇ 依照簡歷表內容，以自我介紹方式進行口試，參訓紀錄、就業規劃、參訓動機。
 - ◇ 為維持雙方權益，口試進行中全程錄音。
5. 其他說明：詳細甄試說明、錄訓後通知與本課程相關資訊將以 e-mail 方式通知。
6. 錄訓說明：於甄試當日，以筆、口試方式進行，分數各占百分之五十。筆試及口試總成績達六十分以上始得錄訓為原則，並依筆試、口試成績計算總分及名次後，依序錄訓，如總分同分者，以筆試成績高者優先錄訓，未參加筆試或口試者，一律不予錄訓。
7. 備取生遞補：正取生放棄報到後，依備取順序遞補至開訓日起實際上課日 4 日。

■ 課程費用及補助說明

1. 課程費用 35,952 元。政府負擔 (80%) 費用：28,762 元，學員自行負擔 (20%): 7,190 元。
2. 參訓學員於開訓日(含)以前檢具特定失業者身分證明文件者 (具有就業保險法所定非自願離職者、就業服務法所定特定對象身分者及其他依行政規則所定得免費參訓者，詳細說明詳簡章第六頁)，得免繳自行負擔之個人訓練費用。
3. 學員自行負擔之訓練費，應於**開訓前**繳交予訓練單位，並向訓練單位索取收據正本；已報名繳費但因故無法參訓者，**得於開訓前申請退還所繳費用**，未於開訓前申請者，**已繳交之訓練費用，除該班次停辦外，一律不予退還**。

※個人訓練費用匯款資訊：

戶名：國立陽明交通大學，匯款銀行：玉山商業銀行新竹分行(銀行代號 808)

帳號：9550-084-0560-911

煩請學員匯款後，來信或以 Line 留言方式提供匯款帳號後 5 碼，以利帳務作業。

■ 課堂用書

學員在**正式錄訓**後，將依照課程規畫提供課堂用書，以下為書籍明細：

	書名	搭配課程
1	半導體製程技術導論(第三版)	IC製程技術
2	Fundamentals of Electric Circuits 7 th edition	電子電路學
3	Introduction to Electrodynamics 4 th edition	電磁學概論
4	Introduction to Quantum Mechanics 3 rd edition	近代物理與量子科技導論
5	Optics 5 th edition	幾何光學/傅氏光學
6	Optoelectronics & Photonics: Principles & Practices 2 nd edition	幾何光學/傅氏光學
7	Semiconductor Physics and Devices: Basic Principles 4 th edition	IC製程技術
8	Microelectronic Circuits 8 th edition	電子電路學

※課堂用書由辦訓單位提供，贈書細節將於錄訓後通知，實際用書以錄訓通知為主。

■ 課程注意事項

1. 為確保您的上課權益，報名後若未收到任何回覆，請來電洽詢方完成報名。
2. 如需取消報名，請於開課前 3 日以 email 通知主辦單位聯絡人並電話確認。
3. 為尊重講師之智慧財產權益，恕無法提供課程講義電子檔。
4. 為配合講師時間或臨時突發事件，主辦單位有調整日期或更換講師之權利。
5. 學員請務必留意出缺勤時數，如需請假，請務必填寫請假單。如遇離（退）訓，須依規定填寫離訓申請單。

※學員於參訓期間有下列情事之一，訓練單位應報請機關(分署)同意後，辦理退訓：

- 1.) 曠課時數達全期訓練總時數 4%者。
 - 2.) 未到課時數達全期訓練總時數 10%者。
 - 3.) 參訓期間行為不檢情節重大者。
 - 4.) 參訓期間未達總訓練時數 1/2 且找到工作而未能繼續參訓者。
 - 5.) 參訓期間無前項離訓事由而未能繼續參訓者。
6. 結訓證書：學員受訓期間成績合格者，可獲得結訓證書。

※學員中途離訓、經訓練單位勒令退訓或考核成績未達標準者，將不發給結訓證書。

7. 企業說明會或媒合相關活動將依照與企業排定之日期為主，將於課程期間通知學員。
8. 詳細課表請參照附件，課程授課形式原則上以線上為主，部分實體課程請務必留意。

※實體課程若遇疫情或其他不可抗力因素須改為線上授課，將會另行通知學員。

■ 權益說明：學費補助身分

職前訓練免負擔費用學員身分別及參訓權益說明如下：

失業者身分		資格條件及應檢附證明文件
1	就業保險被保險人非自願離職失業者	<p>一、資格條件：檢附最後離職投保單位所出具非自願離職事由之證明文件，並經公立就業服務機構推介安排職業訓練。</p> <p>二、應備文件：</p> <p>(一)國民身分證正反面影本或有效期間之居留證影本。</p> <p>(二)公立就業服務機構開立之職業訓練推介單。</p>
2	獨力負擔家計之失業者	<p>一、資格條件：</p> <p>(一)失業者具下列情形之一，且獨自扶養在學或無工作能力之直系血親、配偶之直系血親或前配偶之直系血親者：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 配偶死亡。 2. 配偶失蹤，經向警察機關報案協尋，達6個月以上未尋獲。 3. 離婚。 4. 受家庭暴力，已提起離婚之訴。 5. 配偶入獄服刑、因案羈押或依法拘禁。 6. 配偶應徵集、召集入營服義務役或替代役。 7. 配偶身心障礙或罹患重大傷、病致不能工作。 8. 其他經公立就業服務機構認定或經直轄市、縣(市)政府社政單位轉介之情況特殊需提供協助。 <p>(二)因未婚且家庭內無與申請人有同居關係之成員，而獨自扶養在學或無工作能力之直系血親卑親屬者。</p> <p>(三)因原負有法定扶養義務者死亡、失蹤、婚姻、經濟、疾病或法律因素，致無法履行該義務，而獨自扶養在學或無工作能力之血親者。</p> <p>二、應備文件：</p> <p>(一)國民身分證正反面影本。</p> <p>(二)註記現住人口及詳細記事之全戶戶口名簿影本。</p> <p>(三)全戶內年滿15歲至65歲受撫養親屬之在學或無工作能力證明文件影本：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 在學證明指25歲以下仍在國內公立或已立案之私立學校就讀在學證明文件(但不包含就讀空中專科及大學、高級中等以上進修學校、在職班、學分班、僅於夜間或假日上課或遠距教學)。 2. 無工作能力證明文件指罹患重大傷、病，經醫療機構診斷必須治療或療養3個月以上之診斷證明文件。 <p>(四)其他足資證明身分之文件。</p>
3	中高齡之失業者	<p>一、資格條件：年滿45歲至65歲間之失業者。</p> <p>二、應備文件：國民身分證正反面影本。</p>

失業者身分		資格條件及應檢附證明文件
4	身心障礙之失業者	一、資格條件：領有身心障礙手冊或證明之失業者。 二、應備文件： (一)國民身分證正反面影本。 (二)有效期限內之身心障礙手冊或證明文件影本。
5	原住民之失業者	一、資格條件：戶籍登記為原住民之失業者。 二、應備文件： (一)國民身分證正反面影本。 (二)註記原住民身分之戶口名簿影本。
6	低收入戶或中低收入戶中有工作能力之失業者	一、資格條件：指社會救助法中所規定之低收入戶或中低收入戶內，有工作能力而自願就業之失業者。 二、應備文件： (一)國民身分證正反面影本。 (二)低收入戶或中低收入戶身分證明文件影本。
7	長期失業者	一、資格條件：指連續失業期間達1年以上，且辦理勞工保險退保當日前3年內，保險年資合計滿6個月以上，並於最近1個月內有向公立就業服務機構辦理求職登記者。 二、應備文件： (一)國民身分證正反面影本。 (二)開訓前1個月內向公立就業服務機構辦理求職登記證明文件。
8	二度就業婦女之失業者	一、資格條件： (一)因家庭因素退出勞動市場2年，重返職場之婦女。 (二)退出勞動市場期間： 1. 自該婦女最近1次勞工保險效力停止之翌日起算。 2. 未有勞工保險投保紀錄者，自其最後任職事業單位出具服務證明所載離職日之翌日起算。 二、應備文件： (一)國民身分證正反面影本。 (二)因家庭因素退出職場佐證文件影本(如以親屬重大傷病卡或身心障礙證明佐證因家庭照顧因素、以戶口名簿證明結婚、生育或親屬年邁等、或以切結書切結說明；親屬範圍參照勞工請假規則第3條勞工喪假喪亡對象)。 (三)無勞保紀錄者，需再檢附最後任職事業單位出具之服務證明(載明離職日)。 (四)其他足資釋明身分之資料。

失業者身分		資格條件及應檢附證明文件
9	家庭暴力被害人失業者	一、資格條件：家庭暴力被害人。 二、應備文件： (一)國民身分證正反面影本。 (二)下列證明文件之一： 1.直轄市、縣(市)政府開立之家庭暴力被害人身分證明文件。 2.保護令(通常保護令、暫時保護令、緊急保護令)影本。 3.判決書影本。
10	更生受保護人之失業者	一、資格條件：更生受保護人。 二、應備文件： (一)國民身分證正反面影本。 (二)出監證明或其他更生受保護人身分證明書正本。
11	15歲以上未滿18歲有就業需求之未就學未就業少年	一、資格條件：年滿15歲以上未滿18歲之未就業未就學少年。未就學係指完成國民義務教育階段，且無學籍或休學狀態。 二、應備文件： (一)國民身分證正反面影本。(二)切結書。 (三)如為休學中，應再檢附休學證明文件。
12	新住民之失業者	一、資格條件：符合促進新住民就業補助作業要點第2點第1項第3款規定之新住民失業者。 二、應備文件：有效期間之居留證明文件。
13	性侵害被害人失業者	一、資格條件：性侵害被害人。 二、應備文件： (一)國民身分證正反面影本。 (二)下列證明文件之一： 1.直轄市、縣(市)政府開立之性侵害被害人身分證明文件。 2.保護令(通常保護令、暫時保護令、緊急保護令)影本。 3.判決書影本。
14	跨國(境)人口販運被害人失業者	一、資格條件：經檢察官鑑別為跨國(境)人口販運被害人失業者。 二、應備文件： (一)參訓期間有效之臨時停留許可證影本。 (二)勞動部核發之工作許可影本。
15	無戶籍國民失業者	一、資格條件：符合入出國及移民法第16條第3項規定取得居留之泰國、緬甸地區單一中華民國國籍之無戶籍國民失業者。 二、應備文件：臺灣地區居留證影本。
16	無國籍人民失業者	一、資格條件：符合入出國及移民法第16條第3項、第4項規定取得居留身分之泰國、緬甸、印度或尼泊爾地區無國籍人民，且已依就業服務法第51條第1項第1款規定取得工作許可之失業者。 二、應備文件： (一)外僑居留證影本。 (二)勞動部核發之工作許可函影本。

失業者身分		資格條件及應檢附證明文件
17	因犯罪被害之失業者	<p>一、資格條件：符合下列資格，並於犯罪事實發生後6年內報名參訓者：</p> <p>(一)因犯罪行為被害而死亡者之配偶或直系親屬。</p> <p>(二)因犯罪行為被害受重傷者之本人、配偶或直系親屬。</p> <p>(三)因犯罪行為被害死亡者或受重傷者之未成年子女之監護人。</p> <p>二、應備文件：</p> <p>(一)國民身分證正反面影本。</p> <p>(二)財團法人犯罪被害人保護協會開立之因犯罪被害之身分證明書正本。</p>
18	因重大災害受災之失業者	<p>一、資格條件：依勞動部因應重大災害職業訓練協助計畫認定之因重大災害受災之失業者。</p> <p>二、應備文件：</p> <p>(一)國民身分證正反面影本。</p> <p>(二)下列受災證明影本之一：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 鄉(鎮、市、區)公所開立之房屋受損證明。 2. 農政機關或單位開立之農作物受損證明。 3. 家屬因重大災害死亡或重傷之證明。 4. 相關政府機關開立之重大災害受災證明文件。
19	受貿易自由化影響失業者	<p>一、資格條件：符合充電起飛計畫第6點第1項第2款規定之受貿易自由化影響失業者。</p> <p>二、應備文件：</p> <p>(一)國民身分證正反面影本。</p> <p>(二)屬適用本對象資格條件之勞工相關證明文件(可由系統勾稽者免繳)。</p>
20	自立少年之失業者	<p>一、資格條件：符合衛生福利部社會及家庭署訂定之提升少年自立生活適應協助服務量能計畫之自立少年資格，且於身分證明文件有效期限內報名參訓之失業者：</p> <p>(一)以年滿15歲以上未滿18歲經2處以上安置，仍無法適應機構生活，經主管機關評估有需要且具自立生活能力者優先，且應至少服務至其年滿18歲。</p> <p>(二)年滿18歲結束安置1年內者。</p> <p>(三)結束安置逾1年，經主管機關評估仍有必要提供自立生活適應協助者。</p> <p>(四)其他經受委託之安置教養機構或民間團體評估有需要自立生活，報經地方主管機關核定同意提供其自立生活適應協助者。</p> <p>二、應備文件：</p> <p>(一)國民身分證正反面影本。</p> <p>(二)地方主管機關開立之自立少年身分證明文件。</p>

失業者身分		資格條件及應檢附證明文件
21	其他經直轄市、縣(市)政府或其委託計畫之社工人員訪視評估確有經濟困難，且有就業意願之失業者	一、資格條件：經直轄市、縣(市)政府或其委託計畫之社工人員訪視評估確有經濟困難，且有就業意願。 二、應備文件： (一)國民身分證正反面影本。 (二)公立就業服務機構開立之職業訓練推介單。
22	年滿65歲以上之失業者	一、資格條件：年滿65歲以上之失業者。 二、應備文件：國民身分證正反面影本。
23	就業保險被保險人自願離職失業者	一、資格條件：曾取得就業保險法被保險人身分之自願離職失業者。 二、應備文件：國民身分證正反面影本或有效期間之居留證影本。
24	其他經中央勞政主管機關認為有必要者。	資格條件及應備文件依規定辦理。

※具備前述各項身分之失業者，如加保於職業工會、農會或漁會，得以「報名參訓資格審查切結書」切結確實無工作，而以原失業者身分免費參訓。

※非屬前述各項身分、且參加職業工會、農會或漁會勞工保險之被保險人，比照一般國民參加失業者職業訓練，須自行負擔 20%之訓練費用。

■ 權益說明：生活津貼及學習獎勵金

職前訓練課程依照學員的資格分為生活津貼及學習獎勵金，下表簡述大綱，細節將於表後描述：

類型	適用對象	給付金額 (皆給付至多 2 個月)	撥款單位
生活津貼	被保險人非自願性離職	每月按申請人離職辦理本保險退保之當月起前 6 個月平均投保薪資百分之六十發給「職業訓練生活津貼」，最長發給 6 個月。	勞工保險局
	就業服務法第 24 條第 1 項各款所列失業者	申請人於訓練期間每人每月按基本工資百分之六十發給職訓生活津貼 (申請金額將會依基本工資有所調整，2022 年基本工資為 25,250 元，基本工資之 60% 為 15,150 元)，最長發給 6 個月。	訓練單位
學習獎勵金	15-29 歲本國籍失業青年	每月 8,000 元 * 如已參加產業新尖兵並已領取過，則不得再領取	桃竹苗分署

一、職業訓練生活津貼

(一)全日制職業訓練，應符合下列條件：

訓練期間 1 個月以上；每星期訓練 4 日以上；每日訓練日間 4 小時以上；每月總訓練時數 100 小時以上。

(二)參訓期間得申請職業訓練生活津貼身分別

1. 非自願離職失業者

需於報名截止日前先至公立就業服務機構安排職訓諮詢，經適訓評估後持該機構開立之「職業訓練推介單」及「就業保險職業訓練生活津貼給付申請書及給付收據」報名參加全日制職業訓練，經甄試錄訓後，其職業訓練生活津貼由勞工保險局發放。

非自願離職失業者如同時具有下列第 2-11 項所列身分者，應優先以非自願離職身分申請就業保險法職業訓練生活津貼。若未優先申請就業保險法職業訓練生活津貼，將不予核撥就業促進津貼實施辦法職業訓練生活津貼，系統會持續勾稽至結訓後 2 年，若發現有違反規定之情形，將撤銷及追繳已領取之津貼。

2. 獨力負擔家計者：本人及受扶養親屬戶口名簿影本(受撫養親屬年滿 15 歲至 65 歲者，需再檢具「在學證明書」或「無工作能力證明」文件影本)。

甲、具下列情形之一，且獨自撫養在學或無工作能力之直系血親、配偶之直系血親或前配偶之直系血親者。

A、配偶死亡。

B、配偶失蹤，經向警察機關報案協尋，達 6 個月以上未尋獲。C、離婚。

D、受家庭暴力，已提起離婚之訴。

E、配偶入獄服刑、因案羈押或依法拘禁。

F、配偶應徵集、召集入營服義務役或替代役。

G、配偶身心障礙或罹患重大傷、病致不能工作。

H、其他經公立就業服務機構認定或經直轄市、縣(市)政府社政單位轉介之情況特殊需提供協助。

乙、因未婚且家庭內無與申請人有同居關係之成員，而獨自扶養在學或無工作能力之直系血親卑親屬者。

丙、因原負有法定扶養義務者死亡、失蹤、婚姻、經濟、疾病或法律因素，致無法履行該義務，而獨自扶養在學或無工作能力之血親者。

3. 中高齡者：指年滿 45 歲至 65 歲之間者。(以開訓日為計算標準)。

4. 身心障礙者：指領有身心障礙手冊者(未過期之有效資料)。

5. 原住民：戶口名簿已登記原住民者。

6. 低收入戶或中低收入戶中有工作能力者：指鄉鎮區公所開立的低收入戶或中低收入戶中之證明。

7. 長期失業者：指連續失業期間達 1 年以上，且辦理勞工保險退保當日前 3 年內保險年資合計滿 6 個月以上，並於最近 1 個月內(指開訓日前 1 個月內)有向公立就業服務機構辦理求職登記者。

8. 二度就業婦女：因家庭因素離開職場兩年以上的婦女。

*須提出相關證明文件影本：如以親屬重大傷病卡或身心障礙證明佐證家庭照顧因素、以戶口名簿證明結婚、生育或親屬年邁等。

9. 家庭暴力被害人：直轄市、縣(市)政府開立之家庭暴力及性侵害被害人身分證明文件、保護令影本或判決書影本。

10. 更生受保護人：由財團法人台灣更生保護會或地方法院檢察署觀護人士開立的證明書。

11. 其他經中央主管機關認為有必要者：

(1) 新住民(依促進新住民就業補助作業要點)：指與中華民國境內設有戶籍之國民結婚，且

獲准居留在臺灣地區工作之外國人、大陸地區人民、香港居民或澳門居民。

(2.) 性侵害被害人(依促進家庭暴力及性侵害被害人就業補助作業要點)：直轄市、縣(市)政府開立之性侵害被害人身分證明文件、保護令影本或判決書影本。

(3.) 就業弱勢少年：指 15 歲以上未滿 18 歲之未就學未就業少年。

(4.) 高齡者(依失業中高齡者及高齡者就業促進辦法)：指逾 65 歲者(以開訓日為計算標準)，且依就業促進津貼實施辦法第 3 條、第 18 條至第 21 條及第 26 條規定。

(三)補助限制

1. 已領取公教人員保險養老給付、勞工保險老年給付、軍人退休俸或公營事業退休金，不得請領。(前項人員符合社會救助法低收入戶或中低收入戶資格、領取中低收入老人生活津貼或身心障礙者生活補助費者，得適用本辦法)

2. 二年內合併領取職業訓練生活津貼(含就業保險法職業訓練生活津貼)及政府機關其他同性質之津貼或補助，最長以 6 個月為限，申請人為身心障礙者，最長以 1 年為限(依據本辦法第 29 條規定)。前項「政府機關其他同性質之津貼或補助」，係指就業保險法所定之職業訓練生活津貼。請領就業保險法之失業給付或職業訓練生活津貼期間，不得同時請領本辦法第 18 條津貼。(2 年內的起算日係以學員該次參訓始日往前推算 2 年。)

3. 領取本辦法職業訓練生活津貼期間，不得同時請領勞工保險條例中所指稱失業給付及職業訓練生活津貼。扣除不得同時請領期間之津貼後，賸餘之職業訓練生活津貼依第 20 條第 2 項規定辦理。

4. 就業促進津貼實施辦法第 2 條第 1 項第 2 款：「本法第 24 條第 1 項各款所列之失業者」其中「失業者」身分應不具有勞工保險被保險人身分。(職業工會、裁減續保與農漁保除外)

5. 參訓學員於參訓期間，如有受僱參加勞工保險且有工作事實者，即認定為提前就業，應依規定辦理退訓，爰職業訓練生活津貼自退訓之日起停止發放。

6. 領取津貼者經原發給津貼單位予以撤銷時，應繳回已領取之津貼；屬不實領取經撤銷者，二年內不得申領本辦法之津貼。

前項經原發給津貼單位書面通知限期繳回，屆期未繳回者，依法移送強制執行。

二、失業青年職前訓練獎勵（學習獎勵金）

1. 獎勵對象：為本國籍失業青年，年滿十五歲至二十九歲，且參加下列訓練課程之一者：

(1) 本署及分署自辦、委辦或補助辦理之失業者職前訓練。

(2) 產業新尖兵試辦計畫。

年齡之計算，以青年參加訓練課程之開訓日為基準日。

青年依本要點規定領取學習獎勵金，以一次為限。

青年依法領取失業給付或職業訓練生活津貼期間，不得領取本要點之學習獎勵金。

2. 獎勵金：

(1.) 每月發給最高新臺幣八千元；

(2.) 以三十日為一個月計算，一個月以上始發給學習獎勵金；超過三十日之畸零日數，應依下列方式辦理：

◇ 畸零日數期間之訓練時數未達五十小時者，發給半個月。

◇ 畸零日數期間之訓練時數達五十小時者，發給一個月。

3. 補助方式：

(1.) 於開訓後提供銀行存摺封面檔案；

(2.) 待審核通過後，將由分署撥付至學員指定帳戶。

4. 青年有下列情形之一者，分署應不予核發學習獎勵金之全部或一部；已發給者，經撤銷或廢止原核定處分後，應以書面行政處分限期命其返還：

(1.) 不實申領。

(2.) 以同一事由已領取政府機關其他相同性質之補助或獎助。

(3.) 訓練期間中途離訓或遭訓練單位退訓。

(4.) 訓練期間未到課之時數達全期訓練總時數百分之十以上。

(5.) 規避、妨礙或拒絕分署查對。

(6.) 其他違反本要點之規定。

因不實申領學習獎勵金致撤銷原核定處分者，不得再依本要點發給學習獎勵金。

附件：課程規畫表 - 多元半導體人才養成班第 01期

- 課程時段：10:00-12:00 13:30-17:30
- 實際課程時間及課程連結將於開訓前通知

上課日期	課程名稱	綱要	專業學科時數	專業術科時數	授課形式
112/03/01	開訓	開訓典禮	1		實體
112/03/01	入班宣導	就業資源宣導	1		實體
112/03/01	近代物理概論	<ol style="list-style-type: none"> 1. 導入及介紹量子力學的觀念。 2. 配合歷史發展設計課程內容，不只讓學生知道結果，也要讓學生瞭解量子理論的思考方法及過程。 3. 讓學生瞭解量子理論與古典物理的主要不同處。 4. 推導理論來解釋半導體為何與一般導體及絕緣體不同。 5. 介紹半導體材料的基本特性。 	4		實體
112/03/02	近代物理概論	<ol style="list-style-type: none"> 1. The Quantum Theory of Light 2. The Particle Nature of Matter 3. Tunneling Phenomena 4. Quantum Mechanics in Three Dimensions 5. Atomic Structure 		6	遠距
112/03/03	電子電路學	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ohm' s Law 2. Kirchhoff' s Law 3. Series/Parallel Division 	4		遠距
112/03/06	半導體產業講座	無塵室工廠介紹 半導體晶圓廠基本結構 廠務與設備裝機工程設機台配置 半導體製造部與設備部工作內容簡介	4		遠距
112/03/07	光電子學	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fermat' s principle 2. Image formation 3. Ray matrix 4. Ray tracing 5. Prism and mirrors 6. Stops and aperature 	5		遠距

上課日期	課程名稱	綱要	學科時數	術科時數	授課形式
112/03/08	光電子學	1. Aberrations 2. Radiometry and photometry 3. Basic optical devices 4. Image evaluation		5	遠距
112/03/09	電子電路學	1. Nodal Analysis 2. Mesh Analysis 3. Thevenin' s Theorem 4. Norton' s Theorem	4		遠距
112/03/10	IC 製程技術	Characteristics of Semiconductor Materials & Device Technologies	4		遠距
112/03/11	半導體封裝概論	1. 何謂晶片封裝 2. 晶片封裝產業鏈 3. 晶片封裝型態 4. 晶片封裝流程 5. 晶片發展趨勢		5	遠距
112/03/13	IC 製程技術	Characteristics of Semiconductor Materials & Device Technologies	4		遠距
112/03/14	電磁學概論	1. Vector Calculus 2. Theory of Vector Field 3. Electrostatics	5		遠距
112/03/15	電磁學概論	1. Potentials 2. Electric Fields in Matter 3. Magnetostatics		5	遠距
112/03/16	電子電路學	Inverting/Noninverting Amplifiers		4	遠距
112/03/17	IC 製程技術	Silicon and Wafer Preparation & Chemicals in Semiconductor Fabrication	4		遠距
112/03/18	半導體封裝概論	1. 何謂晶片封裝 2. 晶片封裝產業鏈 3. 晶片封裝型態 4. 晶片封裝流程 5. 晶片發展趨勢		5	遠距
112/03/20	IC 製程技術	Silicon and Wafer Preparation & Chemicals in Semiconductor Fabrication	4		遠距
112/03/21	就業趨勢及求職技巧	就業市場趨勢分析及求職技巧	4		實體

上課日期	課程名稱	綱要	學科時數	術科時數	授課形式
112/03/22	傅氏光學	1. Fourier Analysis, Fourier transform and related theorem, sampling theory 2. Angular spectrum of plane waves 3. Rayleigh-Sommer field diffraction integral, Fraunhofer diffraction, Fresnel diffraction 4. Fourier transform properties of a thin lens	5		遠距
112/03/23	傅氏光學	1. Gratings 2. Frequency analysis of optical imaging system 3. Wavefront modulations		5	遠距
112/03/24	電子電路學	1. Operation Amplifier 2. Parallel/Series RLC circuits		4	遠距
112/03/25	半導體封裝概論	6. 何謂晶片封裝 7. 晶片封裝產業鏈 8. 晶片封裝型態 9. 晶片封裝流程 10. 晶片發展趨勢	3		遠距
112/03/27	IC 製程技術	Contamination Control in Wafer Fabs & Gas Control in Process Chambers	4		遠距
112/03/28	IC 製程技術	IC Fabrication Process & Oxidation		4	遠距
112/03/28	班會	班務管理	1		遠距
112/03/29	專題報告	論文研討		6	遠距
112/03/30	電子電路學	Sinusoids and Phasors		4	遠距
112/03/31	IC 製程技術	IC Fabrication Process & Oxidation		4	遠距
112/04/06	IC 製程技術	Deposition & Metallization		4	遠距
112/04/07	性別平等課程	性別平等課程	3		遠距
112/04/07	班會	班務管理	1		遠距
112/04/10	IC 製程技術	Photolithography		4	遠距

上課日期	課程名稱	綱要	學科時數	術科時數	授課形式
112/04/11	半導體人工智慧數據分析之程式語言 ~Python (上)	Python 基本語法:變數、型態、if-else 指令、range()、函數使用、for 指令、while 指令、數據處理案例研討與實作	1	5	遠距
112/04/12	半導體人工智慧數據分析之程式語言 ~Python (下)	Python 進階程式設計:List、Set、Dictionary 等資料結構與函數操作、副程式設計、類別與物件設計、數據應用案例研討與實作	1	5	遠距
112/04/13	半導體人工智慧數據分析之資料收集與處理應用	資料收集、數據資料儲存與讀取、網路爬蟲、正規表示式、Pandas 資料處理	1	5	遠距
112/04/14	半導體人工智慧數據分析之資料分析應用	資料分析技術、Matplotlib 資料視覺化、資料分析案例、資料分析應用	1	5	遠距
112/04/17	IC 製程技術	Etch		4	遠距
112/04/18	半導體人工智慧數據分析之機器學習實務與應用	迴歸、決策樹、隨機森林、貝氏分類器、支持向量機、K-最近鄰居(KNN)、K-平均分群(K-means)、DBSCAN 分群、階層式分群、關聯規則學習	1	5	遠距
112/04/19	半導體智慧製造之應用深度神經網路 ~卷積神經網路(CNN)、實務應用與實作	深度學習工具安裝與介紹、卷積神經網路的架構、卷積運算與化運算、Softmax、梯度下降、損失函數與學習、彩色圖片資料集辨識	2	4	遠距
112/04/20	半導體智慧製造之應用深度神經網路 ~遞歸神經網路(RNN)、長短期記憶網路(LSTM)介紹、實務應用與實作	RNN 和 LSTM 神經網路的架構、認識序列資料、自然語言處理的基礎、遞歸神經網路、長短期記憶神經網路、網路電影資料預測	2	4	遠距
112/04/21	半導體智慧製造之應用深度神經網路 ~半導體智慧製造之預訓練模型與轉移學習	影像增強技術簡介、CNN 網路演進、Keras 內建的預訓練模型、使用預訓練模型進行圖片分類預測、認識轉移學習、預訓練模型的轉移學習、手寫辨識的轉移學習	1	5	遠距

上課日期	課程名稱	綱要	學科時數	術科時數	授課形式
112/04/24	半導體智慧製造之 OpenCV 影像處理	OpenCV 基礎介紹、模型訓練與使用、 實務案例：特徵分類器車牌辨識	1	5	遠距
112/04/25	半導體智慧製造之 Yolo 影像處理	Yolo 基礎介紹、神經網路影像分類、 Yolo 模型建立與權重套用、實務案例： 廠區之防疫口罩辨識	1	5	遠距
112/04/26	電子實驗	光學實作實驗		5	實體
112/04/27	電子實驗	半導體設備介紹概論		4	實體
112/04/28	電子實驗	電路模擬與電子實驗		4	實體
112/04/29	電子實驗	電路模擬與電子實驗		4	實體
112/04/29	結訓	結訓典禮	1		實體
合計			78	134	212

※訓練單位保留調整課程內容與講師等之權利。